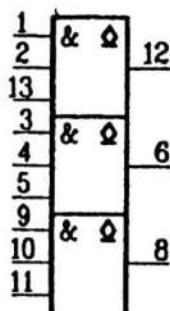


КР1533ЛИ4, КФ1533ЛИ4, ЭКФ1533ЛИ4

Микросхемы представляют собой три логических элемента 3И с открытым коллекторным выходом. Корпус типа 201.14–1, масса не более 1 г и 4306.14–А.

Назначение выводов: 1...5, 9...11, 13 — информационные входы 1D1, 1D2, 2D1, 2D2, 2D3, 3D1, 3D2, 3D3, 1D3; 6, 8, 12 — выходы 2Y, 3Y, 1Y; 7 — общий; 14 — напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ЛИ4, КФ1533ЛИ4, ЭКФ1533ЛИ4

Таблица истинности

Вход			Выход
D1	D2	D3	Y
1	1	1	1
0	1	1	0
1	0	1	0
0	0	1	0
1	1	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
0	0	0	0

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ±10%
Выходное напряжение низкого уровня	≤ 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня	≥ 2,5 В
Прямое падение напряжения на антизвонном диоде	≤ −1,5 В
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения	≤ 3 мА
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения	≤ 1,8 мА
Входной ток низкого уровня	≤ −0,1 мА
Входной ток высокого уровня	≤ 20 мкА
Выходной ток	≤ 0,1 мА
Время задержки распространения сигнала при включении	≤ 20 нс
Время задержки распространения сигнала при выключении	≤ 56 нс
Емкость входа	≤ 5 пФ
Емкость выхода	≤ 7 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации КР1533

Напряжение питания	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход .	5,5 В
Температура окружающей среды	-10...+70 °С

Общие рекомендации по применению КР1533, КФ1533

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.